Market News

Infineon und SCHWEIZER vertiefen Zusammenarbeit im Chip-Embedding für effizientere Siliziumkarbid-Lösungen im Automotive-Bereich

München und Schramberg – 26. April 2023 – Die Infineon Technologies AG und die Schweizer Electronic AG arbeiten gemeinsam an einem innovativen Ansatz zur Steigerung der Effizienz von Siliziumkarbid (SiC)-Chips. Dazu entwickeln die Partner eine Lösung, um 1200-V-CoolSiC™-Chips von Infineon direkt in Leiterplatten (PCB) einzubetten. Durch einen höheren Wirkungsgrad können so die Reichweite von Elektroautos erhöht und die Gesamtsystemkosten gesenkt werden.

Beide Unternehmen haben das Potenzial des neuen Ansatzes bereits unter Beweis gestellt: Sie konnten einen 48 V MOSFET in eine Leiterplatte (PCB) einbetten. Das führte zu einer Leistungssteigerung von 35 Prozent. SCHWEIZER trägt zu diesem Erfolg mit seiner innovativen p² Pack®-Lösung bei, die das Einbetten von Leistungshalbleitern in Leiterplatten ermöglicht.

„Wir verfolgen gemeinsam das Ziel, die Automotive-Leistungselektronik auf das nächste Level zu heben“, sagt Robert Hermann, Product Line Head Automotive High-Voltage Discretes and Chips, von Infineon. „Die niederinduktive Umgebung einer Leiterplatte ermöglicht ein sauberes und schnelles Schalten. In Kombination mit der hervorragenden Performance der 1200 V CoolSiC-Produkte ermöglicht die Chipeinbettung hochintegrierte und effiziente Wechselrichter, welche die Gesamtsystemkosten senken.“

„Mit den zu 100 Prozent elektrisch getesteten Standardzellen (S-Cell) von Infineon können wir hohe Gesamterträge im p² Pack-Fertigungsprozess erzielen“, sagt Thomas Gottwald, Vice President Technology der Schweizer Electronic AG. „Die schnell schaltenden Eigenschaften der CoolSiC-Chips werden durch die niederinduktive Verschaltung, die mit dem p² Pack erreicht werden kann, optimal unterstützt. Dies führt zu einem höheren Wirkungsgrad und einer verbesserten Zuverlässigkeit von Leistungswandlern wie Traktionswechselrichtern, DC-DC-Wandlern oder On-Board-Chargern.“

Public / Für die Fachpresse
Informationsnummer INFATV202304.093d

Infineon Technologies AG
Media Relations:
Reinhard von Faltin
Tel.: +49 89 234 39694
reinhard.vonfaltin@infineon.com

Investor Relations:
Tel.: +49 89 234-26655
investor.relations@infineon.com

Infineon und SCHWEIZER werden die 1200 V CoolSiC Chip Embedding-Technologie auf der PCIM Europe 2023 in Nürnberg am Infineon-Stand 412 in Halle 7 vorstellen. SCHWEIZER ist ebenfalls auf der Messe vor Ort (Stand 410 in Halle 6)

Infineon auf der PCIM 2023

Auf der PCIM Europe 2023 präsentiert Infineon innovative Produkt-zu-System-Lösungen für Anwendungen, die die Welt antreiben und die Zukunft gestalten werden. Auf der begleitenden PCIM Conference und dem Industry & E-Mobility Forum halten Vertreter des Unternehmens mehrere Vorträge mit Live- und On-Demand-Videopräsentationen, gefolgt von Diskussionen mit den Referenten. “Driving decarbonization and digitalization. Together.” am Stand 412 von Infineon in Halle 7, 9. bis 11. Mai 2023 in Nürnberg. Informationen zu den Messehighlights der PCIM Europe 2023 sind erhältlich unter www.infineon.com/pcim.

Über die Schweizer Electronic AG

Die Schweizer Electronic AG steht für modernste Spitzentechnologie und Beratungskompetenz in der Leiterplattenindustrie. Durch die hochmodernen Produktionsstätten in Schramberg/Deutschland und Jintan/China sowie den engen Partnerschaften mit anderen Technologieführern bietet SCHWEIZER individuelle Leiterplatten- & Embedding-Lösungen. SCHWEIZERs innovative Leiterplatten-Technologien kommen in anspruchsvollsten Anwendungen, wie z.B. in den Bereichen Automotive, Aviation, Industry & Medical sowie Communications & Computing zum Einsatz und zeichnen sich durch ihre höchste Qualität und ihre energie- und umweltschonenden Eigenschaften aus. Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt (Ticker Symbol „SCE“, „ISIN DE 000515623“) zugelassen. Weitere Informationen erhalten Sie auf: www.schweizer.ag.

Medienkontakt Schweizer Electronic AG:

Rainer Jäckle
Telefon: +49 7422 / 512-291
Email: rainer.jaeckle@schweizer.ag